



Produktbeschreibung:

Die **COBAR OT2 SN100C®** ist eine bleifreie Lotpaste der nächsten Generation.

Hinter dem Kürzel **SN100C®** verbirgt sich eine bei 227°C eutektische Zinn-Kupfer basierte Standardlegierung, die im Cobar OT2-Pastensystem als Pulver Typ 3 und 4 zum Einsatz kommt. Die Zusammensetzung von **SN100C®** ist SnCu_{0,7}Ni_{0,05}Ge_{0,005}. Das innovative Lotpastensystem **COBAR OT2 SN100C®** erlaubt sehr hohe Druckgeschwindigkeiten selbst für kleinste Schablonenöffnungen. Die Benetzungseigenschaften sind ausgezeichnet und beseitigen Graping und Head in Pillow Effekte. **COBAR OT2** hat sehr klare, transparente und sichere Rückstände und in Kombination mit SN100C® ein sehr glänzendes Aussehen.

Zusätzliche Informationen können im Product Data Sheet (PDS) gefunden werden. Die aktuellste Version des PDS kann jederzeit auf unserer Internetseite www.cobar.com gefunden werden. Selbstverständlich erhalten Sie Informationen auch auf www.balverzinn.com oder durch unser Fachpersonal.

Wir verweisen auf das dazugehörige gültige Sicherheitsdatenblatt.

Wareneingang und Lagerung:

1. Versandverpackungen sollten nicht auf der Laderampe oder anderorts verbleiben. Lotpasten sind verderblich. Versandverpackungen sind nur für den Schutz der Paste während des Transports bis zu 4 Tagen geeignet.
2. Versandverpackungen müssen sofort nach Erhalt ausgepackt werden. Eine kühle Lagerung verlängert die Lebensdauer der Lotpaste.
Wenn die Ware innerhalb der nächsten Tage nicht verwendet oder geprüft wird, sollte sie ungeöffnet in einem Kühlraum gelagert werden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 4-10 °C. Temperaturen unter 4 °C sollten jedoch vermieden werden. Auf keinen Fall sollten die Lagertemperaturen 22-25 °C übersteigen. Die Temperaturen in klimatisierten Räumen sind gewöhnlich für eine kurze Lagerung geeignet.
3. Kartuschen sollten waagrecht gelagert und monatlich gedreht werden, um Flussmittel – Separation zu verhindern.

Handhabung:

Vor Gebrauch sollten die noch geschlossenen Dosen / Kartuschen min. 8 Std. Zeit haben, die Umgebungstemperatur zu erreichen. Gefrorene / kalten Behälter **DÜRFEN NICHT** geöffnet werden, da Feuchtigkeit auf den Produkten kondensieren und deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Lotpaste **DARF NICHT** hohen Temperaturen ausgesetzt werden! Handelt es sich um Dosen, rühren Sie das Material für 1 Min. mit einem Spachtel aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl (Vorsichtig um die Dose vom Innen nicht zu beschädigen). Dies homogenisiert das Produkt und bereitet es für die sofortige Verwendung vor.

Offenen Behälter sollten vorzugsweise unmittelbar nach der Entnahme der Lotpaste geschlossen werden. Sollte innerhalb der nächsten Tage keine weitere Lotpaste gebraucht werden, sollte die Lotpaste wieder in das Kühllager. Lotpasten sollten nach FIFO – Prinzip gehandelt werden.

Druckparameter:

Benutzen Sie einen Rakel mit der kleinstmöglichen Länge. Bringen Sie ca. 10g / cm Rakellänge Paste auf die Schablone auf. Der Druckhub sollte ca. 50 mm vor und nach dem Druckbild beginnen, um der Paste ein gutes Rollen zu ermöglichen. Druckereinstellungen hängen von Drucker, den Schablonenmaterialien und der Temperatur ab. Allgemein empfohlene Einstellungen:

| Druckgeschwindigkeit [mm/s] | Rakeldruck [kg/cm] bei 23°C |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 25 – 100 | 0,2 (0,50 kg/inch) |
| 100 – 200 | 0,25 (0,65 kg/inch) |

Verringern Sie den Druck um jeweils 5% pro 1°C höhere Umgebungstemperatur. Trenngeschwindigkeit für Standard – Leiterplatten 10 mm/s. Für MPM Maschinen Stufe 6.

Empfohlene Verarbeitungstemperatur von 22 – 28 °C und 30 – 70 % relativer Luftfeuchte.

In Falle von Druckpausen größer 4 Stunden wird empfohlen eine komplette Schablonenreinigung durchzuführen.

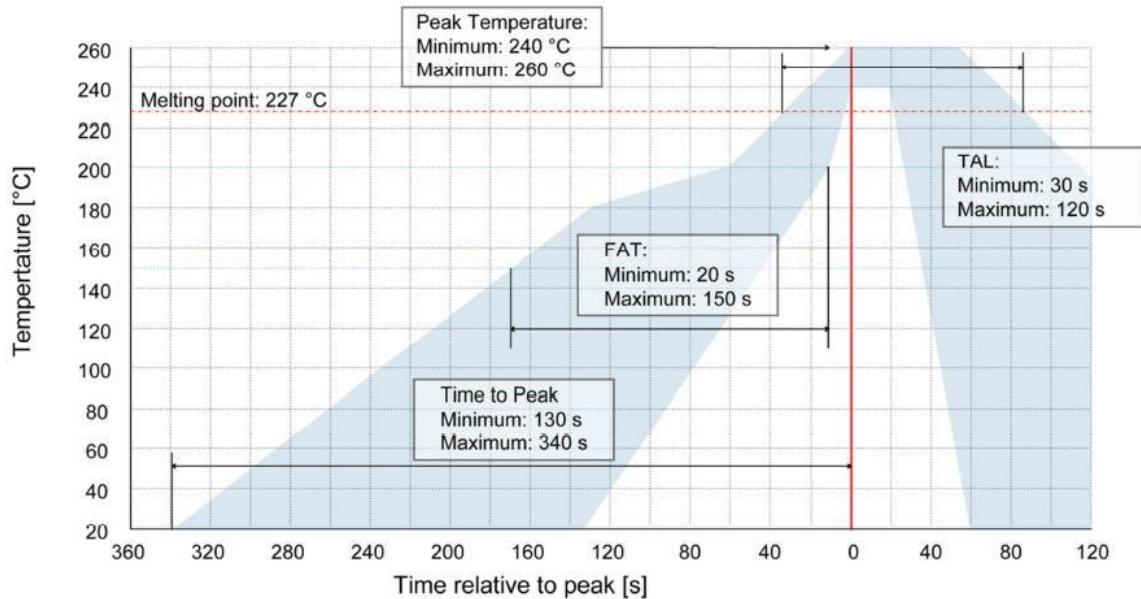
Elektronik Application Note

BALVER ZINN[®]
COBAR[®]

COBAR OT2
SN100C[®] – SnCu_{0,7}Ni_{0,05}Ge_{0,005}

Reflowprofil:

Die bedruckten Baugruppen können bis zu 8 Stunden nach dem Druck gelötet werden, ohne nennenswertes nachlassen der Eigenschaften. Unsere Profilempfehlung sollte nur als ein Richtprofil angesehen werden, um die erste Einstellung vorzunehmen. Das Endprofil hängt auch vom Equipment, der Baugruppe und vielen anderen Faktoren ab.



FAT = Flussmittel Aktivierungszeit
TAL = Zeit über Schmelztemperatur
Tp = Peak Temperatur

Rückstände / Reinigung:

COBAR OT2 SN100C[®] ist eine No-Clean Formulierung. Diese Lotpaste hinterlässt minimale, nicht korrosive Flussmittelrückstände mit sehr guten dielektrischen Eigenschaften. Die Rückstände können in den meisten Applikationen auf der Baugruppe verbleiben. Rückstände auf Schablonen, Rakeln, Spachteln und sonstigen Werkzeugen können problemlos mit dem **Reiniger MCI-2330** entfernt werden.

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG **nicht** übernommen werden.